

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	海通证券、淳厚基金、华夏基金、国泰君安、华夏久赢、建信基金、富国基金、诺安基金、平安基金、招商证券、交银施罗德基金、太平资产、国金证券等 94 家机构，共约 139 人次，详见下表。
时间	2022 年 5 月
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长李晓冬 董事会秘书柏林 证券事务代表王小红
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分 公司基本情况介绍 <p>公司 38 年专注于功能性陶瓷粉体材料的研发、生产和销售，是国内行业龙头企业，拥有功能性陶瓷粉体填料（如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料等）独立自主的系统化知识产权。公司是国家高新技术企业，被工信部认定首批专精特新“小巨人”企业，入选第六批国家级制造业单项冠军示范企业。</p> <p>公司主要产品：除了传统角形硅微粉、圆角硅微粉、微米级球形硅微粉、亚微米级球形硅微粉、球形氧化铝粉产品之外，Low α 微米级球形硅微粉、Low α 亚微米级球形硅微粉、Low α 微米级球形氧化铝粉以及面向异构集成技术封装的低 cut 点、更高密度的紧密填充、多种表面改性剂复配改性产品、客</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>户需要特殊设计处理的其他粉体材料正逐步增加比重。</p> <p>随着新一代信息技术领域快速发展，新兴应用场景带来对半导体产品的性能、功耗等要求提升，半导体产品逐步从传统封装向先进封装转变，先进封装市场和承载的 PCB 基板（新一代覆铜板）需求将维持较高速的增长，涉及公司主要业务球形功能性陶瓷粉体材料迭代研发、生产和销售。产品应用于：芯片封装用环氧塑封材料(EMC)和底部填充材料(Underfill)、印刷电路板用覆铜板(CCL)、热界面材料 (TIM)、新能源汽车电池模组导热胶黏剂、太阳能光伏电池结构胶黏剂；面向节能环保的建筑用胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体；以及特高压电工绝缘制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。</p> <p>2021 年度，公司实现营业收入 6.25 亿元，同比增长 54.55%；实现归母净利润 1.73 亿元，同比增长 55.85%；实现归母扣非净利润 1.56 亿元，同比增长 68.85%。</p> <p>2022 年一季度，公司实现营业收入 1.77 亿元，同比增长 27.28%，实现归母净利润 0.43 亿元，同比增长 16.35%；实现归母扣非净利润 0.41 亿元，同比增长 20.72%。</p> <p>第二部分 互动交流</p> <p>问题 1：天然气涨价对公司的影响？公司如何看待天然气的价格趋势？</p> <p>答：2021 年下半年以来，天然气价格出现了异常增长，四季度相比三季度增长明显，导致公司球形产品的成本出现阶段性增长，虽然公司经过工艺改进消化了一部分，但是 2021 年四季度、2022 年一季度球形产品毛利率依然有了一定的下降。</p> <p>受俄乌战争的影响，天然气价格前期增长幅度较大，目前天然气的价格整体趋势稳中有落。</p>
---------------------------	---

投资者关系活动
主要内容介绍

问题 2：目前公司球形硅微粉从价格和客户覆盖面来看，与竞争对手相比情况如何？

答：球形硅微粉目前大批量应用于环氧塑封料、覆铜板、陶瓷等领域。

在环氧塑封料领域，公司实现全球全覆盖，不仅实现了行业内客户的全覆盖，而且实现了产品规格、品种的绝大部分覆盖。从 SOP\QFN\BGA 到 MUF 封装实现全覆盖，从常规产品到 Low a 产品实现全覆盖，公司与竞争对手相比具备明显的优势。公司对于常规、低端的产品毛利率控制在合理范围内，该类产品价格与竞争对手相比略低；QFN\BGA\MUF 等中高端封装中应用的产品价格与竞争对手相比基本接近。

在覆铜板领域，公司 Low Df（低介质损耗）球形硅微粉广泛应用于各等级高频高速基板，特别是部分球形硅微粉满足了 M6 级别以上的 Ultra Low Df（超低介质损耗）覆铜板的性能要求，并实现了批量销售。微米级的产品在国内鲜有竞争对手进入该行业，目前该类产品的毛利率公司认为在合理范围内。除了个别厂商，基本上实现了日韩、欧美和大陆以及台资厂等行业一线客户的全覆盖。

在陶瓷领域，目前还没有联瑞新材的竞争对手在批量进入该领域供应。联瑞新材在该领域具有明显的性价比优势。

问题 3：如何看待球形氧化铝的发展空间？

答：随着电子产品功能日趋复杂且小型化发展趋势，电子产品发热散热问题日益突出。目前，新能源汽车也迎来了快速发展的窗口机遇期。为了保证新能源电动汽车的核心部件“三电”（电池组、电控系统、驱动电机）及充电桩的安全性能与使用寿命，需要用到热界面材料让热量及时有效地释放出去。由此可见，导热填料的需求及市场是日趋明显的。

联瑞新材的球形化技术涵盖了配方设计、工艺优化、品质

投资者关系活动
主要内容介绍

标准以及客户适用性评判等方面。公司目前已经拥有 3 个系列球形氧化铝，即常规系列球形氧化铝、低钠系列球形氧化铝和高导热系列球形氧化铝。公司产品除了在中国大陆销售以外，还在日本、韩国、欧美、东南亚、台湾等国家和地区实现销售，公司和诸多国内外知名客户建立了紧密的合作关系。我们看好球形氧化铝产品市场前景及后续发展，目前市场上性价比适宜、用量较大的导热填料主要是球形氧化铝。国内外客户对于公司球形氧化铝产品的技术、品质以及交付能力是信赖的。近年，公司球形氧化铝产品订单呈持续增长趋势。公司将继续加大研发投入，及时满足高端导热粉体填料市场及增长需求。

问题 4：未来球形氧化铝是否会替代球形硅微粉？

答：球形氧化铝相对具有热导率高、填充率高、性价比好等优点，目前市场上用量大、导热率高、性价比好的填料主要是球形氧化铝。球形氧化铝的应用行业主要有：1）热界面材料如导热垫片、导热硅脂、导热灌封胶及导热凝胶等；2）导热工程塑料；3）导热铝基覆铜板；4）高导热塑封料；5）特种陶瓷领域等。

球形氧化铝与球形硅微粉产品性能物性和特征不同，在不同的聚合物体系中表现的特点不同，承担不同的功能和性能提升。目前来看，球形氧化铝不会替代球形硅微粉。

问题 5：2021 年球形硅微粉在环氧塑封料和覆铜板行业的销售占比如何？

答：2021 年应用于环氧塑封料和覆铜板行业的球形硅微粉同比 2020 年均呈增长趋势。球形硅微粉在环氧塑封料行业的销售占比高于覆铜板行业。

问题 6：15000 吨球形粉体产线建设进度如何，什么时候投产？

投资者关系活动
主要内容介绍

产品主要应用在哪些行业？

答：目前年产 15000 吨产线建设项目按计划进行中，预计 2022 年第四季度试生产。产品主要应用于环氧塑封料高端封装领域，推动国内高端芯片封装材料的产业升级。

问题 7：公司氮化物产品的进展情况？

答：公司氮化物粉体材料开发已进入实验室阶段。

问题 8：公司与生益科技投资产业基金的目的是什么？目前基金的进度如何？

答：本基金的投资方向与公司的主营业务相关，主要投资方向如下：（1）以基金合伙人中上市公司业务为核心的电子基材、信息技术产业链上下游；（2）新材料行业，重点布局 5G 通信材料和半导体材料，适当延伸覆盖新能源材料和航天材料等；（3）配合国家发展高端制造、半导体和新材料的产业引导政策，挖掘有发展潜质的项目。

从长远发展来看，我们并不排斥对在未来可能孵化出来的项目的并购等。目前基金设立在有序推进中，我们会根据相关要求，及时履行信息披露义务。

问题 9：公司原材料成本是否有上升？

答：同比 2020 年，公司原材料、燃料动力、运费等成本整体有上升，但是目前已经趋稳并有所下降。

问题 10：公司主要产品规划布局？

答：公司的战略是坚持研发、生产、销售多种粉体填料。通过持续近 40 年的研发经验和技術积累，公司拥有在功能性陶瓷粉体填料（如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料等）领域独立自主的系统化知识产权。产品应用于：芯片封装用环

投资者关系活动
主要内容介绍

氧塑封材料（EMC）和底部填充材料（Underfill）、印刷电路板基板用覆铜板（CCL）、热界面材料（TIM）、新能源汽车电池模组导热胶黏剂、太阳能光伏电池结构胶黏剂；面向环保节能的建筑用胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体；以及特高压电工绝缘制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。

公司持续聚焦芯片先进封装、新一代高频高速覆铜板、新能源汽车动力电池模组和光伏电池胶黏剂等领域，应用于异构集成技术封装、底部填充材料（Underfill）的亚微米级球形硅微粉、应用于存储芯片封装的 Low α 微米级球形硅微粉和 Low α 亚微米级球形硅微粉、Low α 微米级球形氧化铝、应用于 Ultra Low Df（超低介质损耗）电路基板的球形硅微粉、应用于热界面材料的高 α 相球形氧化铝粉等高尖端应用的系列化产品已通过海内外客户的认证并批量出货，液态填料已小批量出货。

公司持续开展 Low α 亚微米级球形氧化铝粉产业化、研发投入化学法制备微纳米球形二氧化硅、硅基氮化物粉体、铝基氮化物粉体、球形氧化镁等产品的研究开发。公司始终高度重视研发创新和产品升级迭代，着眼于市场发展的趋势和客户多样化的需求，持续夯实公司的核心技术优势，保持强劲的核心竞争力。

问题 11：请介绍一下公司 2022 年的经营计划。

答：（1）加强市场和销售工作。2022 年，公司将紧密围绕行业发展趋势，持续做好公司产品研发和客户新品开发同步协作，依靠多年来公司在填料领域积累沉淀的成熟、先进的生产技术，不断向其他新型功能性填料延伸，紧抓覆铜板、芯片封装材料、热界面材料、新能源电池模组粘结材料、蜂窝陶瓷载体、3D 打印等下游领域的发展机遇，提前布局未来市场拓展的先机。公司将紧盯全球半导体以及相关产业链的重构趋

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>势，面向全球布局在欧洲、北美和亚洲的市场份额，确保公司全球全产业链的销售业务的稳定持续发展。</p> <p>（2）研究创新方面，紧抓芯片成品封装转型机会，继续坚持球形填料等向大颗粒精确切割、更加紧密的填充、高纯度、高导热性、特殊的电性能等方面发展，重点对标面向 5G 需求的高频高速覆铜板应用以及先进封装中关键的异构集成封装材料应用需求的球形陶瓷粉体材料。</p> <p>（3）扎实推进新增产线的产能建设。2022 年，高效推进年产 15000 吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目建设并试生产，不断满足下游客户的新增需求，综合提升公司的业务规模和产品的市场占有率。公司围绕 2022 年战略部署，在深耕现有产品和业务的基础上，不断拓展新领域、开发新技术、研制新产品、开拓新市场，坚持以客户为中心，为客户提供有竞争力的解决方案。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>详见附件</p>

附件

参会机构名单

序号	参会机构名称
1	海通证券
2	上海趣时资产管理
3	上海盘京投资管理 2 人
4	上海焱牛投资管理
5	Indus Capital
6	光大自营
7	兴业基金 2 人
8	前海开源基金
9	中银国际资管
10	敦和资产管理
11	华泰柏瑞基金
12	淳厚基金 2 人
13	德邻众福投资管理 2 人
14	上海宏流投资管理
15	上海明河投资管理
16	上海天猗投资
17	融通基金
18	国寿安保基金
19	华夏基金 2 人
20	上海合远私募基金 2 人
21	浙江九章资产管理
22	交银康联人寿保险
23	乘果投资
24	中华联合财产保险
25	长盛基金
26	弘毅远方基金
27	国泰君安 2 人
28	弘尚资产
29	国联安基金 3 人
30	西部利得基金
31	歌斐诺宝
32	兴合基金 2 人
33	泓德投资管理
34	华宝基金 2 人
35	Octo Rivers 瀚川投资
36	长江养老保险

序号	参会机构名称
37	兴银基金
38	浙江九章资产管理
39	财通证券资产管理
40	兴业银行理财子公司
41	T Rowe Price 普信
42	景顺长城基金
43	深圳多鑫投资
44	天治基金
45	方正富邦基金
46	上海信托
47	圆信永丰基金
48	浙商证券
49	红土创新基金
50	浦银安盛基金
51	华安基金
52	Indus Capital
53	海通研究所
54	途灵资产
55	中英人寿
56	兴华基金
57	广发证券资产管理
58	建信信托
59	益民基金
60	大摩华鑫
61	拾贝投资
62	信达澳亚
63	湘财基金
64	创金合信
65	海富通
66	睿远基金 3 人
67	国华人寿
68	泰达宏利 2 人
69	泰康资产
70	新华资产
71	建信基金
72	华夏久赢 2 人
73	富国基金 12 人
74	诺安基金

序号	参会机构名称
75	平安基金 2 人
76	招商证券 2 人
77	农银基金
78	交银基金 2 人
79	申万菱信基金
80	华商基金
81	摩根华鑫基金
82	江信基金
83	方正证券资管
84	招证国际
85	光大证券资管
86	理成资产
87	景顺长城基金
88	中信证券
89	WCM
90	上海盛宇投资 4 人
91	民生证券 2 人
92	国金证券
93	常春藤 7 人
94	太平资产 7 人